

EVG announces NanoCleave™ layer release technology revolutionizing advanced semiconductor process – September 25, 2022

EVG introduced NanoCleave™, a revolutionary layer release technology for silicon that enables ultra-thin layer stacking for front-end processing, including advanced logic, memory and power device formation, as well as semiconductor advanced packaging. NanoCleave is a fully front-end-compatible layer release technology that features an infrared (IR) laser that can pass through silicon, which is transparent to the IR laser wavelength. As a result, NanoCleave enables silicon wafer carriers in advanced packaging processes such as Fan-out Wafer-level Packaging (FoWLP) using mold and reconstituted wafers as well as interposers for 3D Stacked ICs (3D SIC). "NanoCleave will help enable our customers to realize their advanced device and packaging roadmaps through a highly versatile and universal layer release technology that works with standard silicon wafers and wafer processes – enabling seamless integration in the fab and saving our customers both time and money." stated Paul Lindner, executive technology director at EV Group.



증권 · 금융 | 부동산 | 전기 · 전자 | 전기 · 수송 · 하이브리드 · 자동차 | 테크 | 탄소중립 · ESG | 스마트팩토리 · 자동차 | 태양광 · 신재생에너지 | 배터리 · 파워리튬 · 충전인프라 | 시차

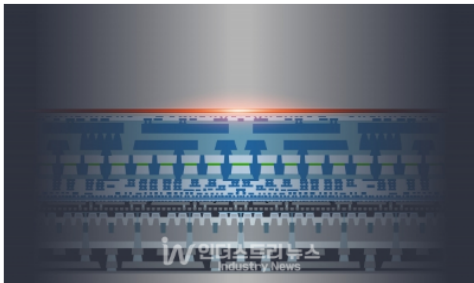
HOME > 리포트 > 이슈 토크쇼

EVG, 첨단 반도체 공정 혁신하는 '나노클리브' 레이어 릴리즈 기술 발표

최창현 기자 | 승인 2022.09.25 08:30 | 댓글 0

전문 장비-공정 솔루션 제공 기업으로 3D 작업 프로세스 등 지원

[인더스트리뉴스 최창현 기자] MEMS, 나노기술, 반도체 시장용 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 장비 분야를 선도하는 EV그룹(이하 EVG)은 반도체 제조를 위한 혁신적인 레이어 릴리즈 기술 '나노클리브(NanoCleave)'를 출시한다고 밝혔다.



EVG는 반도체, 나노기술을 이용 소자 제조에 필요한 장비 및 공정 솔루션을 제공하는 전문기업이다. (사진-EVG)

나노클리브 기술은 실리콘을 투과하는 파장대를 가진 적외선(IR) 레이저를 사용해 반도체 건공정에 완벽히 호환되는 레이어 릴리즈 기술로 스칼라 트랜지스터 메모리 스핀트 반도체 스프린트 엔드 공정 스칼라 반도체 초박형 레이어 적층 등에 사용 가능하다.

특히 이 기술을 특수 조성된 무기질 레이어와 함께 사용하면, 나노미터 수준 높은 정밀도로 초박형 필름이나 레이어를 실리콘 캐리어로부터 IR 레이저로 릴리즈 할 수 있다.

몰딩과 재구성 웨이퍼를 사용하는 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FoWLP) 혹은 3D Stacking IC(3D SIC)을 위한 인터포저 같은 첨단 패키징 공장에서 실리콘 웨이퍼 캐리어 사용이 가능하고, 고온 공정에도 적용 가능한 3D IC 및 순차 집적 애플리케이션에서 새로운 공정 플로우 환경을 제공한다.

EVG 홀 린드너 기술이라는 "반도체 공정 노드를 축소하는 것이 갈수록 더 복잡하고 어려워지고 있지만, 업계에서는 더 높은 디바이스 성능 및 집적도 달성을 위한 새로운 프로세스와 집적 방법을 원하고 있다"며, "나노클리브는 반도체 업계의 요구 사항을 해결할 잠재력을 가지고 있고, 유연하고 범용성이 뛰어난 레이어 릴리즈 기술로 EVG의 고객들이 첨단 디바이스 및 패키징 로드맵을 실현할 수 있게 지원할 것"이라고 강조했다.

한편, EVG는 반도체 나노기술을 이용 소자 제조에 필요한 장비 및 공정 솔루션을 제공하는 전문기업으로 계속기기를 포함한 주요 제품 외에도 웨이퍼 세정장비 및 검사 시스템 등을 생산 중이다.

가장 많이 본 뉴스

- 1 미국 스타트업 일렉터, 주형
- 2 고속도로 호환성 전기차 충전
- 3 양동, 10일 중 세계 최초 '전
- 4 LG엔솔, IRA 발표 북미 지역
- 5 포스트코리얼, OI 협력사?
- 6 한EV 실적 150선 에스케이이
- 7 시스틸베이스, 아이올하이엔
- 8 코어스, K5인용루터 부품사
- 9 그로파트(Growatt), 고출력
- 10 디지털 전환 시대, CEO 리드



영상 · 뉴스



프로카드 뉴스